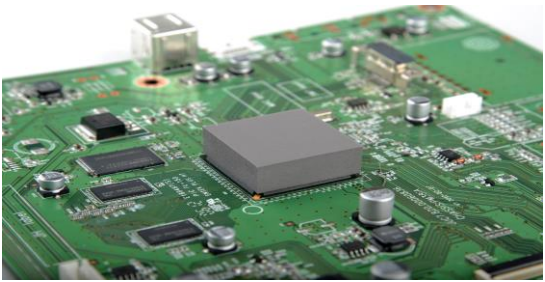


# TP1000-H65-9

## 高导热硅胶垫片

TP1000-H65-9是一款10.0W/m·K的高导热性能的材料，表面弱粘性，适用于大功率发热元器件的导热散热系统，可用于填充小缝隙和不均匀表面，满足UL 94 V-0的阻燃等级要求。



### 特性和优点

- 导热系数: 10.0W/m·K
- 高导热
- 低渗油
- 高电气绝缘
- 韧性好易操作
- 高压缩率、低压缩力

### 典型应用

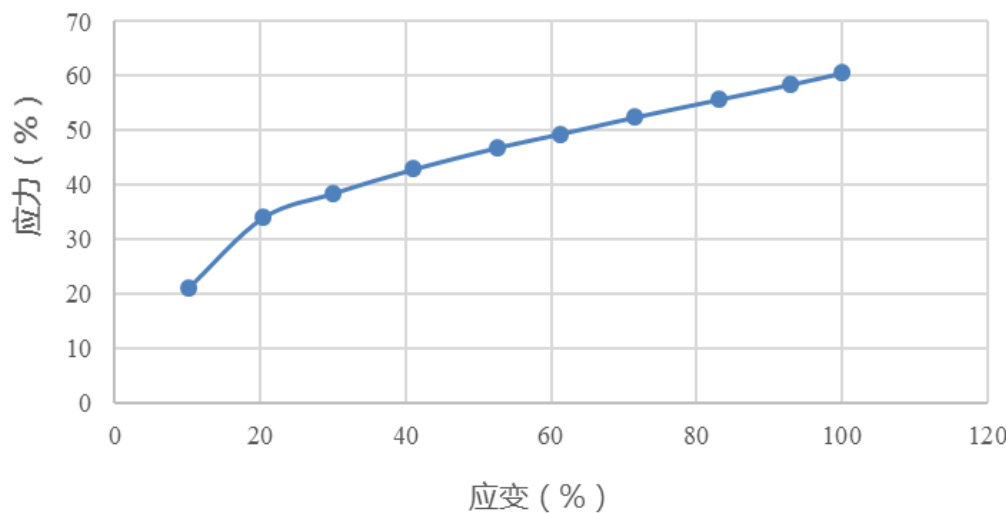
- 电压调节模块 (VRMs)
- ASICs和DSPs
- 高导热需求模块
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM
- 网络通信设备

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
厚度(mm)	0.4~5.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.3	ASTM D792
硬度(Shore OO)	60	ASTM D2240
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
电性能		
击穿电压(kV/mm)	> 6.0	ASTM D149
介电常数@1MHz	7.0	ASTM D150
体积电阻率(Ω.cm)	10 <sup>11</sup>	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/m-K)	10.0	ISO 22007-2

# TP1000-H65-9

## 高导热硅胶垫片

应力-应变曲线图( T=0.9)



应力-应变曲线图( T=2.0)

